**项目名称：微孔互连玻璃基板技术开发**

**一、合作企业概况**（每个企业300字左右）

**（一）**芜湖长信科技股份有限公司系2000年4月成立的股份制高新技术企业；2010年5月在创业板上市（股票代码300088）；为芜湖市第一家在创业板上市企业；公司注册资金为24.55亿元。经过二十多年的努力，长信科技在触控显示行业快速成长，成为国内该行业为数不多的具有核心竞争力的优秀企业，公司凭借其创新的解决方案占据了行业的领先地位。目前为全球最大的ITO导电玻璃制造商，TFT液晶基板减薄也是国际上综合能力最强，车载触控显示模组综合实力位居国内前列，手机LCM模组为国内高端手机品牌指定供应商。公司现有员工近2万人。

**二、项目内容简介**（每个项目400字左右）

（包括项目概况，项目研究内容，如何在项目中进行人才培养等等）

微孔互连玻璃基板技术开发项目是由芜湖长信科技股份有限公司与安徽工程大学合作开展的，双方于2024年10月签订正式横向合作项目。本项目旨在实现微通孔互连玻璃基板（TGV）技术开发与产业化，是下一代三维集成先进封装中的关键核心技术，属于国家重大科技项目中集成电路装备及关键材料领域范畴。本项目具体研究内容包括以下三项：

（1）从工艺角度设计微孔加工方案，以满足高精度、高效率、窄节距、侧壁光滑、垂直度好、高深径比等要求；

（2）对微孔内金属化工艺进行研究，研究镀膜的材料、工艺，满足高附着性、高耐候性、CTE一致性好、电学性能优的要求；

（3）对加工好微孔并金属化的玻璃基板进行检测研究，制定检测方案和方法，并反馈产品稳定性方案。

该项目着眼于加速人才链对产业链的创新驱动。早在2022年，双方就已在推进联合人才联合培养、科技资源共享等方面深度合作，全面提升校企协同育人能力和人才培养模式。在本项目培养过程中，将始终坚持以实践为导向，注重学生技能的全面发展，打破传统教育中单纯依赖书本和PPT的模式，让学生在真实场景中锻炼技能。

**三、校企导师信息**（每个导师300字左右）

（个人简介）

1. **校内导师**

林信南，教授，安徽工程大学集成电路学院副院长（主持工作），长期致力于第三代半导体产业的发展和研究创新，曾在北京大学深圳研究生院从事科研工作 15 年，曾任科研处副处长，主持了国家 973A类课题、三项国家自然基金， Sci/Ei 收录论文180余篇，授权专利若干。是“先进电子器件与集成应用” 深圳市重点实验室主任。自 2009 年起任北京大学驻深圳方正微电子有限公司科技特派员，联合开展功率器件结构、工艺与模型提参等研发工作，曾共同获得深圳市创新奖，并于 2012 年联合开发第三代半导体器件结构与制造工艺，2013 年获广东省金博奖创新突出贡献奖，共同申请了第三代半导体功率器件专利59项，共同合作项目达十余项，2022年6月获华为松山湖实验室和深圳实验室联合颁发的“卓越贡献 成就产业”勋章。

**（二）企业导师**

齐彦杰，博士，任芜湖长信科技股份有限公司研发中心副总监、安徽工程大学产业教授、2024 年度芜湖市经开区优秀青年人才、安徽省高等研究院企业导师，为多金属氧酸盐簇-有机分子笼及多面体骨架的构筑和性能研究（国家自然科学基金，面上基金）和铟-有机孔材料的异金属化研究（国家自然科学基金，青年基金）等项目的主要参与人和完成人，发表 SCI 收录学术论文10余篇，2021 年主持芜湖市科技计划重点研发项目-《高清晰度无闪点防眩玻璃开发》。授权专利71 项，其中发明专利 12 项。